

기술분석보고서 IT

미코(059090)



작성기관 NICE평가정보(주) 작성자 이서원 연구원

[▶ YouTube 요약 영상 보러가기](#)

- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미게재 상태일 수 있습니다.
- 텔레그램에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-2124-6822)로 연락하여 주시기 바랍니다.

- ▶ 요약
- ▶ 기업현황
- ▶ 시장동향
- ▶ 기술분석
- ▶ 재무분석
- ▶ 주요 변동사항 및 전망

미코(059090)

세라믹 기반 기술력으로 반도체에서 에너지·환경으로의 사업 확장

기업정보(2025.10.30 기준)

대표자	이석윤
설립일자	1999.07.16
상장일자	2002.01.15
기업규모	중견기업
업종분류	IT
주요제품	세라믹 소재, 후공정 패키징 부품, 특수코팅 부품

시세정보(2025.10.30 기준)

현재가(원)	14,510
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	4,849
발행주식수	33,416,778
52주 최고가(원)	17,620
52주 최저가(원)	6,980
외국인지분율(%)	9.04
주요주주	전선규, 국민연금공단, (주)에이아이앤엠넷, 노현영

■ 에너지·환경 분야로 사업을 확대 중인 세라믹 전문기업

(주)미코(이하 동사)는 미코 그룹의 지주회사이자 세라믹 소재, 반도체 후공정 패키징 부품, 탄소 소재 기반 특수코팅 부품 사업을 영위하는 세라믹 전문기업이다. 동사는 반도체 장비용 부품의 정밀세정 및 특수코팅 사업을 영위하는 (주)코미코, 세라믹 부품 제조업을 영위하는 (주)미코세라믹스, 세라믹 공정 장비 설계 및 국산화 장비를 제조하는 (주)미코하이테크를 통해 반도체 사업부문에서 세라믹 전문기업으로서 지위를 공고히 하고 있다. 또한, (주)미코파워와 현대중공업파워시스템(주)를 통해 에너지·환경 사업 분야로 포트폴리오 다각화를 실현하고 있다.

■ 세라믹 파우더부터 탄소 복합소재까지 탄탄한 기술력 보유

계열사들과 별개로, 동사는 독자적으로 세라믹 파우더(Ceramic Powder) 사업, Package Biz. 사업 및 Carbon Biz. 사업을 영위하고 있다. 세라믹 파우더 사업은 고순도화 전처리 기술과 고에너지 분산/밀링 기술로 고객 맞춤형 제품을 공급한다. Package Biz. 사업은 패키징 핵심 부품을 판매하며, 질화알루미늄(AIN) 소결 기술을 기반으로 펄스 히터 국산화를 통해 경쟁력을 확보하고 있다. Carbon Biz. 산업은 화학 기상 침투 반응(CVIR) 기술과 탄소 복합소재 기반 세라믹 표면처리 기술을 바탕으로 첨단 세라믹 부품, 열처리 부품을 고객사에 공급한다. 또한, 동사는 신성장동력 확보를 위해 파인 세라믹 소재 개발을 통한 포트폴리오 다양화를 목표로 투명 세라믹, 차폐용 코팅 분말, 전장용 MLCC(Multilayer Ceramic Capacitor) 등의 연구개발을 진행 중이다.

■ 상부 펄스 히터 해외 시장 진입을 통한 신사업 본격화

동사는 외산 제품에 의존하던 상부 펄스 히터 국산화에 성공하였다. 대만과 중국의 주요 반도체 패키징 업체에 TC 본더(Thermo-Compression Bonder, 열압착 본더)를 공급하는 해외 장비기업 고객사를 확보하며 상부 펄스 히터 해외 시장에 진입하여 경쟁력을 강화하고 있다.

요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2022	4,148	13.5	643	15.5	-312	-7.5	-33.23	-4.31	94.3	-1,653	4,503	N/A	1.63
2023	3,817	-8.0	299	7.8	-20	-0.5	-25.04	-0.26	127.8	-816	2,410	N/A	3.77
2024	5,405	41.6	946	17.5	765	14.2	20.43	6.87	161.4	542	3,220	14.79	2.49

기업경쟁력

반도체 분야 소재/부품 기술경쟁력 보유	- 세라믹 원료의 고순도화 전처리 기술, 고에너지 분산/밀링 기술을 고도화하여 반도체 제조 공정 장비 및 차세대 공정에 필요한 소재 개발 경쟁력 보유 - 질화알루미늄 세라믹 소재 기반 펄스 히터 국산화 실현 및 국내외 경쟁력 확보 - 독자적인 화학 기상 침투 반응 기술과 탄소 복합소재 기반 세라믹 표면처리 기술 보유
사업 포트폴리오 다각화	- 세라믹 소재 제품으로 반도체 전공정(식각/세정/증착 공정에 소모품으로 사용) 시장 진입 - 반도체 패키징 공정(본딩)의 핵심 부품인 펄스 히터 국산화로 반도체 후공정 시장 진입 - (주)미코하이테크 지분 인수로 세라믹 소결 기술 내재화 - (주)미코파워를 통해 고체산화물 연료전지 관련 신재생 에너지 산업 진출 - 현대중공업파워시스템(주) 편입으로 에너지·환경 사업 경쟁력 강화

핵심 사업분야

세라믹파우더 사업	계열사 (주)미코세라믹스의 주요 부품 원재료이자 (주)코미코의 코팅 핵심 원재료인 세라믹 원료 분말 가공 관련 소재기술 보유	세라믹 기반의 다양한 사업 진행		
Package Biz. 사업	열 관리 종합 솔루션, TC 본딩 장비 부품(펄스 히터, 하부 히터, 파츠 등), 고객 맞춤형 디자인 설계 기술력 확보	Ceramic Powder	Package Biz.	Carbon Biz.
Carbon Biz. 사업	태양광 셀 제조 핵심장비인 PECVD(Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition) 부품에 대한 표면 처리 기술, 고기능성 탄소 복합소재 관련 기술력 확보			

시장경쟁력

글로벌 네트워크망 형성	글로벌 주요 반도체 생산지역(미국, 중국, 대만, 싱가포르, 일본)에 거점을 확보하며 안정적인 글로벌 네트워크망을 형성하고 있으며, 주요 고객사로 SK하이닉스, 삼성전자, Intel, Micron 등을 확보
업무 표준화를 통한 운영효율 향상	ISO 인증(품질경영시스템, 환경경영시스템, 안전보건경영시스템, 정보보안경영시스템) 확보를 통해 업무 표준화를 실현하여 안정적인 사업화 환경 구축
지속가능한 성장 기반 마련	에너지·환경 사업으로 포트폴리오를 다각화하며 ESG 경영을 실현하고, 정부의 탄소중립 정책에 부합하는 사업 모델을 구축하여 장기적인 성장 동력 마련과 함께 외부 환경 변화에 대한 다양한 수익원 확보

ESG(Environmental, Social and Governance) 활동 현황

E 환경경영	◎ 환경경영시스템 ISO 인증 보유 및 탄소중립 녹색경영 환경부장관상 수상 ◎ 발생 폐기물을 전량 재활용 처리를 진행하여 자원순환 및 친환경 활동에 기여 ◎ 빗물재이용시설을 설치하여 용수 사용량 저감 활동 진행
S 사회책임경영	◎ 산학협력활동(1社1校) 연계 재능기부와 재정기부로 사회공헌 실현 ◎ 제품 기부 및 교육지원 사업, 의료구호 봉사 등 사회공헌활동 진행 ◎ 사회복지기관 직원들에게 지식나눔 강의 실시, 봉사활동, 연탄기부, 헌혈 등 사회공헌 활동 수행 ◎ 직원 워라밸(Work-Life Balance) 지원을 위한 유연근무제, 육아휴직 제도 운영
G 기업지배구조	◎ 감사/회사회계팀 및 외부감사팀을 중심으로 감사기구 운영(회계관리, 핵심감사사항 선정 등) ◎ 매년 3월 정기주주총회를 통한 기업 운영 관련 논의사항 공유 ◎ 코스닥 시장 상장으로, 주주현황 및 재무정보를 투명하게 공개

I. 기업 현황

반도체 사업에서 에너지·환경 사업으로 포트폴리오 다각화를 실현하는 세라믹 전문기업

동사는 독자적으로 세라믹 파우더, 반도체 후공정 펄스 히터, 탄소 소재 코팅 관련 핵심기술력을 확보하고 있으며, 종속회사 운영을 통해 반도체 및 디스플레이 세정/코팅, 세라믹 부품, 공정 장비, 에너지·환경 사업으로 사업범위를 확장하며 포트폴리오 다각화를 실현하고 있다.

■ 기업 개요

동사는 1999년 반도체 및 정밀세정·세라믹 부품 사업을 목적으로 설립되었으며, 2013년 4월 (주)미코로 사명을 변경 후 세라믹 소재에 관한 기술과 노하우를 기반으로 반도체 장비 부품 및 에너지·환경 신사업을 전개하고 있다. 반도체 세정/코팅 전문 계열사인 (주)코미코는 정밀세정 분야의 기술을 바탕으로 국내외 반도체 장비 제조사를 대상으로 고부가가치 특수코팅 서비스를 제공하고 있으며, 세라믹 전문 계열사인 (주)미코세라믹스를 통해 반도체용 고기능 세라믹 부품 시장에 진출하였다. 아울러 고체산화물 연료전지, 방열기관, 고체 전해질, 환경설비 등 신재생 에너지 및 친환경 사업으로 사업 영역을 확장하고 있다. 최근에는 (주)미코파워와 현대중공업파워시스템(주) 등 계열사를 중심으로 연료전지 및 폐기물 에너지화 기반 친환경 발전소 운영 사업도 병행하고 있다.

■ 주요 연혁 및 대표이사 주요 이력

동사는 정밀세정 및 코팅기술 사업을 시작으로, 2002년 1월 코스닥 시장 상장 이후 2013년 (주)코미코를 물적분할하면서 사명을 (주)미코로 변경하였다. 이때 신설된 (주)코미코는 정밀세정 및 특수코팅 사업에 집중하고 있다. 2020년 2월에는 반도체 세라믹 부품 제조사업부를 분할하여 (주)미코세라믹스를 설립하였고, 2021년 1월에는 고체산화물 연료전지 사업부를 물적분할하여 (주)미코파워를 신설하였다. 2023년에는 태양광 및 열처리 소재 사업 확대를 위해 (주)코미코의 첨단소재 사업부(카본 소재 부문)를 양수하였으며, 특수목적 장비 기술 내재화를 위해 (주)삼양세라텍을 인수하여 (주)미코하이테크로 사명을 변경하였다. 2024년에는 현대중공업파워시스템(주)를 종속회사로 편입하여 환경 및 폐기물 에너지화 사업 진출을 본격화하였고, 기존에 분산 운영하던 연구시설을 통합하여 2025년 동탄 제3사업장(연구동)을 개소하였다.

대표이사 이석운은 재료공학 석사, 금융공학 석사 학위를 보유하고 있으며, 2020년까지 동사의 경영기획본부장(CFO)으로 재직하다가 2021년 대표이사로 취임하였다. 현재 현장 중심의 기술개발과 사업구조 고도화에 역점을 두며, 반도체·에너지 융합형 중견기업으로의 성장 기반을 마련해 가고 있다.

그림 1. 주요 연혁



■ 종속회사 및 주주현황

동사는 2025년 6월 기준, 총 15개의 종속회사를 보유하고 있다. 주요 종속회사는 반도체 장비용 부품의 정밀 세정 및 특수코팅 사업을 영위하는 (주)코미코, 세라믹 부품 제조업을 영위하는 (주)미코세라믹스, 연료전지 및 신재생 에너지 사업을 영위하는 (주)미코파워, 세라믹 공정 장비 설계 및 국산화 장비를 제조하는 (주)미코하이테크, 환경 및 발전 플랜트 분야로 사업을 확장하기 위해 작년에 편입한 현대중공업파워시스템(주)로 확인된다.

표 1. 주요 종속회사 현황

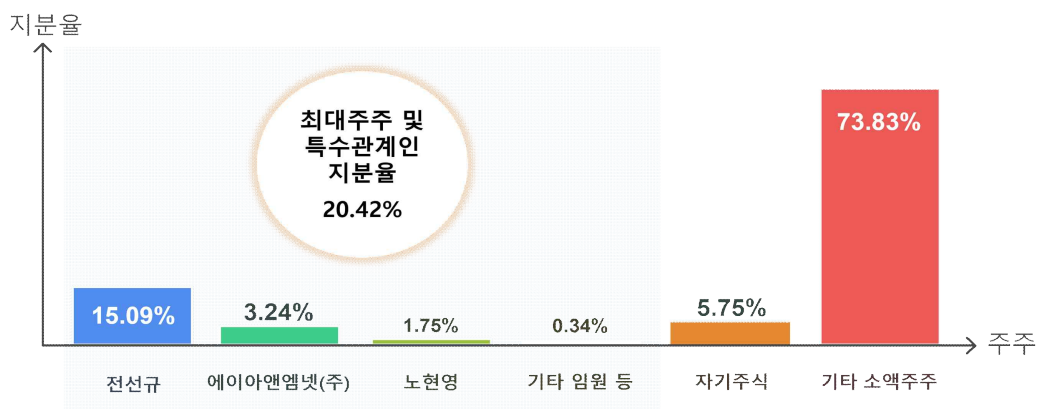
회사명	주요 사업	업계 현황	매출액 (백만 원)*
(주)코미코	반도체 장비 부품 정밀세정 및 특수코팅	반도체 미세공정 고도화에 따라 오염 관리의 중요성이 증가하고 있으며, 맞춤형 품질 시스템이 경쟁력으로 작용함.	39,324
(주)미코세라믹스	정전척, 히터 등 고기능 반도체 부품 제조	반도체 공정 온도 정밀제어 및 정전척 기술 수요가 급증하고 있으며, 기존 금속 히터 대비 절연성, 내열성, 응답 속도 측면에서 세라믹 기반 부품이 빠르게 대체하고 있음.	64,293
(주)미코파워	고체산화물 연료전지 시스템 개발 및 생산	탈탄소 및 분산형 에너지 수요 증가에 따라 고체산화물 연료전지 시장이 성장하고 있고, 5~10kW급 중소형 상업용·건물용 시스템의 국산화 필요성이 대두되고 있음.	2,371
(주)미코하이테크	세라믹 공정 장비 설계 및 국산화 장비 제조	반도체·디스플레이 제조에 사용되는 세라믹 공정 장비의 수입 의존도가 높아 국산화 수요가 증가하고 있음.	2,180
현대중공업 파워시스템(주)	발전 플랜트 및 산업용 보일러 제작	산업용 보일러 및 발전설비 시장은 고효율, 저탄소 연소 기술을 중심으로 재편되고 있으며, 폐열·폐기물 에너지 회수시스템의 수요가 급증하고 있음.	33,767

* 2025년 3월 31일 결산 기준

출처: 동사 반기보고서(2025.06.), NICE BizLINE, NICE평가정보(주) 재가공

2025년 반기보고서 기준, 동사의 최대주주는 전선규 회장으로 5,043,528주(15.09%)를 보유하고 있다. 그 외 에이아이엔엠넷(주) 1,081,078주(3.24%), 전선규 회장의 배우자 노현영 583,947주(1.75%), 기타 임원 등 115,111주(0.34%)를 보유하여 최대 주주 및 특수관계인의 지분율은 20.42%를 나타내었다. 동사의 최대 주주는 동사를 창립한 전선규 회장으로 현재 미코 그룹의 경영을 총괄하고 있다.

그림 2. 주주현황



출처: 동사 반기보고서(2025.06.), NICE평가정보(주) 재가공

■ 사업 분야 및 매출현황

동사는 연결재무 기준으로 반도체 사업과 에너지·환경 사업으로 매출을 집계하고, 별도재무 기준으로 세라믹 파우더 사업, Package Biz. 사업, Carbon Biz. 사업으로 매출을 집계하고 있다. 동사는 미코 그룹 내 (주)코미코, (주)미코세라믹스, (주)미코하이테크를 중심으로 반도체 사업을 영위하고 있고, (주)미코파워와 현대중공업파워시스템(주)를 중심으로 에너지·환경 사업을 영위하고 있다.

2025년 분기보고서에 따르면, 반도체 사업 관련 매출이 64.55%, 에너지·환경 사업 관련 매출이 35.45% 비중을 차지한다. 에너지·환경 사업 부문의 2025년 1분기 매출액은 76,189백만 원으로, 이미 동 사업 부문의 전년도 연간 매출액(13,824백만 원)을 현저하게 넘어섰다. 이는 2024년 편입한 종속회사 현대중공업파워시스템(주)의 지분 확보에 따라 2025년 1분기부터 연결대상에 실적이 반영된 결과가 영향을 크게 미친 것으로 확인된다.

한편, 별도재무 기준으로 세라믹 파우더 사업 부문의 매출 비중은 62%, Package Biz. 사업 부문은 32%, Carbon Biz. 사업 부문과 자회사 관리 수수료 부분이 6%로 구성되는 것으로 확인된다. 동 자료에 따르면, TC 본더에 탑재되는 핵심 부품인 펄스 히터의 쿨 통과(승인)로 해외 시장 진출이 시작되면서 국내외 사업규모 확대가 기대되고, 카본 복합소재를 활용한 태양광 PECVD 장비 부품의 납품 실적에 대한 교체 수요가 계속적으로 발생할 예정이다. 세라믹 파우더 사업의 안정적인 이익 창출 구조로 인해 점진적인 매출 성장을 기대해 볼 수 있다.

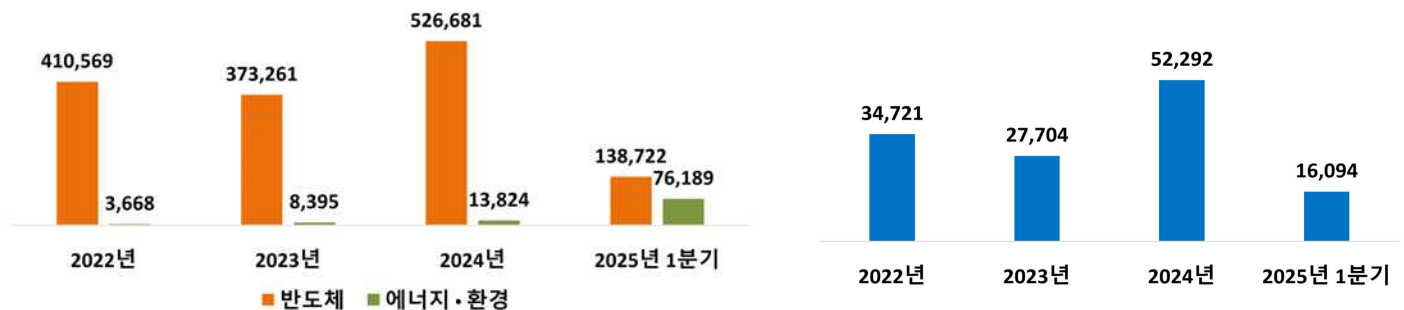
표 2. 사업 분야(연결재무 기준)

사업부문	품목(유형)	주요 사업의 내용	매출액 (백만 원)	매출 비중(%)
반도체	제품/상품 등	• 히터, 정전척 및 세라믹 부품, 세정, 코팅, 디스플레이용 정전척 외 품목 판매	138,722	64.55
에너지·환경	제품/상품 등	• 고체산화물 연료전지 및 신재생 에너지 제품 제작 • 산업용 보일러 및 선박부품 제작/판매	76,189	35.45

출처: 동사 분기보고서(2025.03.), NICE평가정보(주) 재가공

그림 3. 사업부문별 매출 추이 및 동사의 별도 매출 추이

(단위: 백만 원)



사업부문별 매출 추이(연결재무)

동사의 별도 매출 추이(별도재무)

출처: 동사 분기보고서(2025.03.), NICE평가정보(주) 재가공

* 현 중단사업인 바이오 부문의 매출은 미표기

II. 시장 동향

HBM, 고기능성 패키징 수요 확대에 따른 반도체 세라믹 소재 시장 성장 전망

AI 연산에 최적화된 HBM 채택 확산, 첨단 패키징 기술 수요 증가 등이 고기능성 세라믹 소재에 대한 수요로 이어지고 있으며, 세라믹 파우더의 광범위한 활용성은 다양한 산업으로의 확장 가능성을 시사한다.

■ AI, HBM 채택 확산에 따라 고기능성 세라믹 소재 관련 수요 증가

최근 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅, 그래픽 처리 등 데이터 집약적인 애플리케이션에서 메모리 대역폭을 획기적으로 증가시켜 데이터 전송 속도를 높이고, 메모리 병목현상 문제를 해결하는 데 효과적인 고대역폭 메모리(High Bandwidth Memory, 이하 HBM) 기술이 주목받고 있다.

한국수출입은행 해외경제연구소의 2024년 ISSUE REPORT ‘AI가 견인하는 HBM 시장 현황 및 전망’에 따르면, HBM 시장은 2022년 27억 달러에서 2029년 377억 달러로 연평균 46%의 성장세가 전망된다. HBM 수요 증가에는 AI 서버 출하량 증가, AI 서버용 프로세서의 HBM 탑재량 증가 등이 직접적인 영향을 미친 것으로 분석된다. NVIDIA, AMD, Intel 등이 자사 칩에 HBM을 탑재하고 있으며, HBM 시장은 국내 기업인 SK하이닉스와 삼성전자가 양분하며 시장을 선점하고 있는 것으로 확인된다. SK하이닉스는 NVIDIA의 최대 HBM 공급사로, 첨단 HBM 시장에서 점유율 90% 이상을 차지하며 2025년 1분기 전체 D램 시장 시장에서 세계 1위를 33년간 유지해 온 삼성전자(34%)를 2% 차인 36%의 시장 점유율로 제치면서 세계 1위에 오른 것으로 확인(출처: Counterpoint의 ‘SK Hynix Likely Unseated Samsung as DRAM Leader With AI Boost’, 2025)된다. 이처럼 SK하이닉스와 삼성전자가 글로벌 HBM 시장을 선점하고 있는 가운데, HBM 수요 증가에 따른 시장 성장 전망은 SK하이닉스와 삼성전자는 물론 글로벌 기업인 Intel, TSMC, Micron 등을 주요 매출처로 확보하고 있는 동사의 사업실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다.

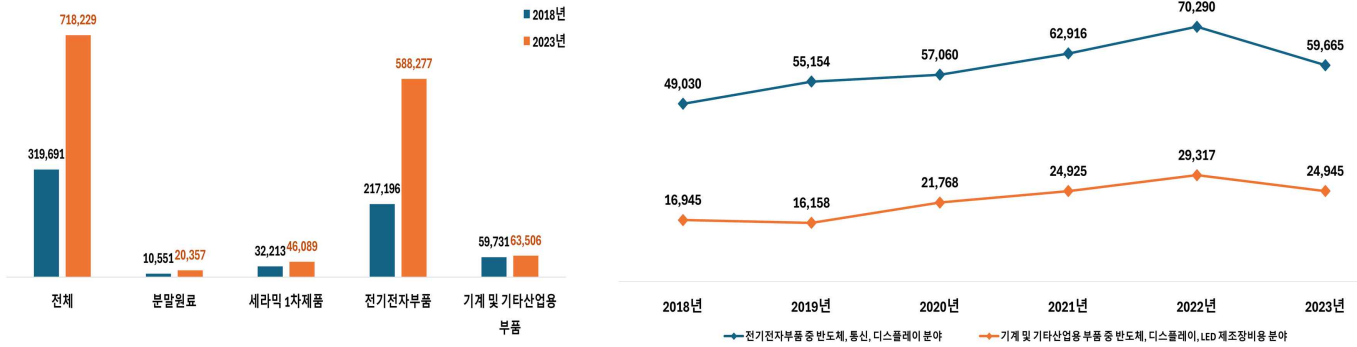
한국수출입은행 해외경제연구소의 2024년 ISSUE REPORT ‘반도체 미세공정의 한계를 극복하는 첨단 패키징’에 따르면, 글로벌 첨단 패키징 시장의 규모는 2023년 378억 달러에서 2029년 695억 달러로 연평균 11% 성장할 것으로 전망되고, AI의 확산 등이 첨단 패키징 시장의 성장을 견인하면서 2027~2028년을 기점으로 첨단 패키징 시장이 기존 패키징 시장보다 커질 것으로 전망된다. 패키징 산업은 전방산업 의존도가 높고, 수요처별로 패키징 요구사항이 상이해 기술별 제조설비 및 공정 보유 여부, 공정 및 설비기술 대응 능력, 납기, 가격 등이 기업경쟁력으로 작용할 수 있다. 또한, 다수의 후공정 장비 기업들은 패키징과 테스트 사업을 병행하며, 파운드리와 전략적 협력관계 구축, 파운드리 공장 인근에 후공정 공장 건설 등을 통해 안정적 물량을 확보하는 전략을 채택하고 있는데, 이는 최근 동사가 대만과 중국의 주요 반도체 패키징 및 테스트 전문기업에 TC 본더를 공급하는 장비기업과 협업하여 테스트를 진행하고 해외 시장 쉐어 및 본격적인 납품 개시가 이루어진 사례와 유사한 방식으로 판단된다. 이러한 산업 동향은 세라믹 소재 관련 기술경쟁력을 갖춘 동사가 국내외 시장에서 고객사 확보, 사업 규모 확장에 긍정적인 요소로 작용할 수 있다.

한편, AI 연산에 최적화된 HBM 채택 확산, 고온 공정에 적합한 패키징 기술, 반도체 장비 내부 부품의 내열성 및 내화학성 확보 필요성 증가는 고기능성 세라믹 소재에 대한 수요로 이어진다. 즉, HBM, 고기능성 패키징 기술 수요, 반도체 장비 부품의 기능성 향상에 있어 알루미나(Al_2O_3), 실리콘 질화규소(Si_3N_4), 질화알루미늄 등 세라믹 소재가 핵심적인 역할을 하기 때문이다. 한국세라믹기술원의 첨단세라믹산업조사에 따르면, 2023년 기준 첨단세라믹산업 참여업체 수는 537개로 확인되며, 매출액 추이는 2018년 31조 9,691억 원에서 2023년 71조 8,229억 원으로 연평균 17.57% 성장세가 확인된다(출처: 통계청 국가통계포털). 보다 세부적으로, 전기전자부품 중 ‘반도체, 통신, 디스플레이 분야’는 2018년 4조 9,030억 원에서 2023년 5조 9,665억 원으로 연

평균 4.00% 성장세가 확인되고, 기계 및 기타산업용 부품 중 ‘반도체, 디스플레이, LED 제조장비용 분야’ 는 2018년 1조 6,945억 원에서 2023년 2조 4,945억 원으로 연평균 8.04% 성장세가 확인된다.

그림 4. 국내 첨단세라믹산업 매출액 추이

(단위: 억 원)



<첨단세라믹산업 매출액 추이>

<반도체, 디스플레이, LED 제조장비용 관련 첨단세라믹산업 매출액 추이>

출처: 한국세라믹기술원(2025), NICE평가정보(주) 재가공

글로벌 시장조사기관 Market Research Intellect의 ‘글로벌 세라믹 파우더 시장’ 분석자료에 따르면, 글로벌 세라믹 파우더 시장은 152억 달러에서 연평균 7.0% 성장세를 보이며 2033년 241억 달러에 이를 것으로 전망하고 있다. 세라믹 파우더는 고유의 내열성, 내마모성, 전기적 특성 등으로 인해 전자 및 전기 산업, 항공 우주 및 자동차 산업, 의료 및 바이오 산업, 에너지 및 환경 산업, 전통 산업 및 기타 첨단 분야(산업용 코팅, 복합재, 방위산업 등) 등에 적용되어 광범위하게 활용되는 특징을 갖는 바, 동사의 세라믹 파우더 핵심기술력은 보다 넓은 분야로의 확장이 가능할 것으로 보인다.

주요기관별 시장전망

글로벌 반도체 장비 시장규모는 2024년 1,130억 달러를 기록하며 전년(2023년) 대비 6.5% 성장할 것으로 전망되며, 전공정 및 후공정 모든 분야에서 성장세가 지속되어 2025년에는 1,210억 달러, 2026년에는 1,390억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

— SEMI(2024)

글로벌 반도체 패키징 시장규모는 2024년 472.2억 달러로 추산되며, 연평균 10.94% 성장하여 2029년 793.7억 달러의 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

— Mordor Intelligence(2024)

글로벌 HBM 시장 규모는 2024년 5억 8천만 달러에서 연평균 31.3% 성장하여 2033년 약 58억 달러 수준의 시장 규모를 형성할 것으로 전망됩니다.

— Astute Analytica(2025)

이러한 성장 전망은 AI를 위한 D램 및 HBM 수요 증가 등이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 그러나 생산비용의 부담, 원재료 공급 불안정과 희소성, 품질 및 환경규제 강화 등이 성장 저하에 요인으로 작용할 수 있습니다.

■ 경쟁업체 현황

동사는 연결재무 기준으로 반도체 사업과 에너지·환경 사업을 영위하고 있으며, 다수의 종속회사와 연결된 사업 네트워크를 형성하고 있다. 동사의 자체적인 기술력인 세라믹 소재 기반 사업과 유사한 사업을 영위하는 해외 기업으로는 Kyocera(일본), NGK Insulators(일본), Tosoh Corporation(일본), Showa Denko(일본), Saint-Gobain(프랑스), CoorsTek(미국) 등이 확인되며, AI와 HBM 수요 확대에 대응하기 위해 고성능 소재 및 부품에 대한 기술경쟁력을 중심으로 사업 역량을 강화하고 있는 것으로 확인된다.

반도체 사업 관련 (주)원익큐엔씨, 하나머티리얼즈(주) 등이 국내 주요 경쟁업체인 것으로 파악되며, 그 외 HBM용 TC 본더 분야에서는 한화세미텍(주), 한미반도체(주) 등의 기업이 포진되어 있는 것으로 보인다. 관련 경쟁업체 현황은 아래의 표와 같다.

표 3. 경쟁업체 현황

기업명	경쟁업체
(주)원익큐엔씨	- 다양한 소재와 기능성 세라믹 부품을 생산하여 반도체, OLED, 자동차 산업에서 통합 솔루션을 제공하고 있음. - 세라믹 부품 일괄 생산체계(원료-소재-가공) 구축과 고객 맞춤형 제품 및 서비스(설계 시뮬레이션, 제작, 평가) 제공으로 시장경쟁력을 확보하고 있음.
하나머티리얼즈(주)	- 반도체 식각공정에 필수적인 실리콘(Si)과 실리콘 카바이드(SiC) 부품을 생산하며 정밀공정 제어 기술을 핵심 기술력을 확보하고 있음. - 반도체 장비 내부에서 고온, 부식, 마모에 강한 특성을 발휘하며 공정의 신뢰성과 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 하는 파인 세라믹스 분야에서 질화알루미늄, 알루미나(Al_2O_3) 세라믹을 생산하며 사업 역량을 강화하고 있음.
한화세미텍(주)	반도체 전공정의 증착 공정, 반도체 후공정의 패키징 공정 장비 사업을 영위 중으로, SK하이닉스에 테스트용 HBM용 TC 본더를 공급하고 있음.
한미반도체	HBM용 TC 본더 세계 점유율 1위 기업(HBM3E 12단 생산용 TC 본더 시장 점유율 90% 이상)이며, HBM4 전용 장비 'TC 본더 4'를 출시하며 AI 반도체 수요에 대응하고 있음.

출처: 각 사 홈페이지 및 보도자료, NICE평가정보(주) 재가공

III. 기술분석

세라믹 파우더 제조 및 고정밀 세라믹 부품 기술 기반 경쟁력 보유

동사는 고도의 세라믹 파우더 공정기술을 보유하고 있으며, 고속 승온 및 냉각 성능을 가진 펄스 히터의 국산화에 성공하는 등, TC 본더 세라믹 부품 관련 우수한 기술력을 확보하고 있다. 또한, 탄소 복합소재 표면처리 기술과 질화알루미늄 히터, 방열기판, Si₃N₄ 소재 등을 중심으로 한 연구개발을 통해 경쟁력을 강화하고 있다.

■ 주요 사업 분야

동사는 세라믹 소재 전문기업으로, 계열사들과 별개로 독자적인 세라믹 원료 분말 가공 기술, 반도체 후공정 패키징용 부품 기술, 탄소 소재 표면처리 기술을 기반으로 세라믹 파우더 중심의 세라믹파우더 사업, 패키징 중심의 Package Biz. 사업, 탄소 소재 중심의 Carbon Biz. 사업을 운영하고 있다. 세라믹파우더 사업은 부품용 분말과 코팅용 분말 사업부문으로 세분화되고, 부품용 분말은 원료 분말과 과립 분말로 세분화되어 고객 요구사항에 따라 맞춤형 제품으로 공급되고 있다. 동사는 세라믹 원료의 고순도화 전처리 기술과 고에너지 분산/밀링 기술을 고도화하여 반도체 제조 공정 장비 및 차세대 공정에 필요한 소재를 개발 및 코팅용 분말에 적용함으로써 내플라즈마 특성과 부품의 수명을 향상시키는 효과를 구현할 수 있어 고객사의 기술발전에도 기여하고 있다.

Package Biz. 사업은 질화알루미늄 소결 기술 기반 히터를 중심으로 기술력을 확보하고 있고, 부품으로 척 플레이트, 가이드 링 등을 생산하여 고객에게 공급하고 있다. 마지막으로 Carbon Biz. 사업은 태양광, OLED, HTT(High Temperature Technology) 부문으로 세분화된다. 동사는 독자적인 화학 기상 침투 반응 기술과 탄소 복합소재 기반 세라믹 표면처리 기술을 활용해 탄소 소재의 내열성과 내마모성을 향상시키며, 태양광 및 반도체 산업의 핵심 부품을 공급하고 있다.

표 4. 동사 사업분야별 주요 제품군

구분		주요 제품군	적용범위
세라믹파우더 사업	부품용 분말	원료 분말(MgAl ₂ O ₄ , Y ₃ Al ₅ O ₁₂), 과립 분말(AlN, Al ₂ O ₃ , Y ₂ O ₃ , Y ₃ Al ₅ O ₁₂)	반도체 전공정(식각, 증착) 장비용
	코팅용 분말	Y ₂ O ₃ Fluorine계 YAG	반도체 전공정(식각) 장비용
Package Biz. 사업	Heater	MPH 시리즈, 상부 펄스 히터(최근 쉘 통과)	반도체 후공정(본딩) 장비용
	부품	척 플레이트, 부착 도구, 계측 빔, 가이드 링	TC 본더, 세라믹 진공 척 플레이트, 금속 코팅 노즐 등
Carbon Biz. 사업	태양광	PECVD 장비 내 핵심 부품 표면 처리기술을 접목한 탄소 복합소재 부품군	SiC 표면처리용 부품, CZ 성장로 부품, 셀 제조 PECVD 공정용 부품
	OLED	OLED 공정용 고온/대면적 히터	OLED
	HTT	RS 시리즈(CVIR-SiC 표면처리), SH-TRC 코팅 처리 제품군	반도체 부품, 장비용 부품, 열처리용 부품

출처: 동사 사업보고서(2024.12.), 반기보고서(2025.06.), 홈페이지, 동사 제공자료, NICE평가정보(주) 재가공

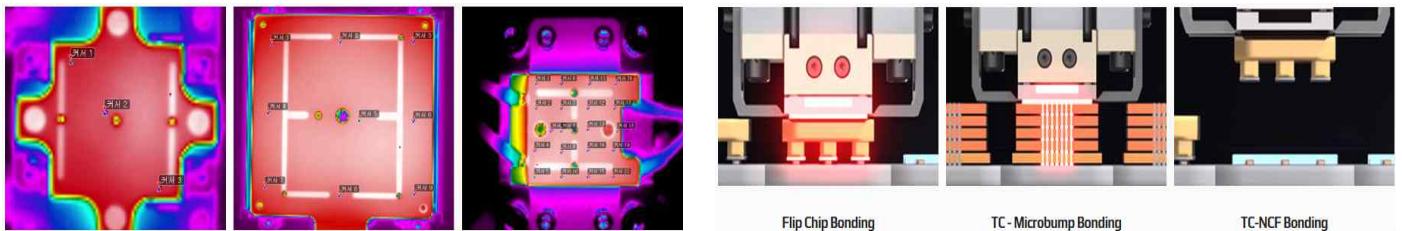
■ 펄스 히터 국산화 및 해외 시장 진입 본격화를 통한 핵심 경쟁력 확보

동사는 20년간 축적된 세라믹 소재 조성 및 소결 기술, 정밀 가공 및 접합 기술을 기반으로 반도체 패키징 후공정에 적용되는 핵심 부품인 히터에 대한 기술경쟁력을 확보하고 있다. 동사는 2023년 TC본더의 하부

스테이지 히터를 개발하여 고객사에 공급을 시작하였고, 최근 상부 펄스 히터에 대해서도 해외 시장에서 켈 통과(승인)를 받아 해외 고객사에 납품을 시작하면서 국내외 HBM 반도체 수요에 대응할 수 있는 핵심 경쟁력을 확보하게 되었다.

동사의 펄스 히터는 질화알루미늄 세라믹 소재를 적용하여 기존 실리콘 카바이드가 적용된 일본산 제품보다 높은 열전도성과 빠른 승온·냉각 특성을 가진다. 50℃에서 450℃까지 온도를 올리는데 필요한 시간은 2초이고, 450℃에서 50℃로 낮추는데 필요한 시간은 5초로, 반응속도가 매우 빠른 것으로 파악된다. 실시간 온도 센서와 정밀 제어 알고리즘을 적용해 목표 온도에 맞춰 균일하게 열을 분포시키고, 반복 공정에도 일관된 품질을 보장한다. 또한, 대구경 제품 생산과 고객 맞춤형 사양 대응이 가능하고, 반복적인 열 충격에도 내구성이 뛰어나 HBM 등 다단 적층 공정에서 웨이퍼 휨 방지와 수율을 개선한다.

그림 5. 펄스 히터 기술 적용 모습 및 적용분야



<동사 기술 적용에 따른 펄스 히터 표면상 균일한 열분포>

<적용분야 - 반도체 후공정(패키징 - 본딩)>

출처: 동사 홈페이지 발췌(2025)

■ 연구개발 활동

동사는 1999년 기술연구소 설립 이후 반도체, 디스플레이 핵심 부품과 관련한 신기술 및 신제품 개발에 집중해 왔으며, 종속회사인 (주)코미코도 세정연구소를 설립하여 반도체 제조 공정용 장비부품 세정기술 개발에 집중하고 있다. 연결채무 기준 동사의 매출액 대비 연구개발 투자 비율(경상연구개발비)은 2023년 8.03%, 2024년 7.24%, 2025년 1분기 기준 4.95%로 확인되며, R&D 투자를 매년 꾸준히 진행하고 있다. 동사는 기존에 분산 운영하던 연구시설(천안, 목포, 안성)을 통합해 2025년 2월 동탄 제3사업장(연구동)을 개소하였으며, 단계별 장비 업그레이드를 통해 연구개발 역량을 지속적으로 강화할 계획인 것으로 확인된다.

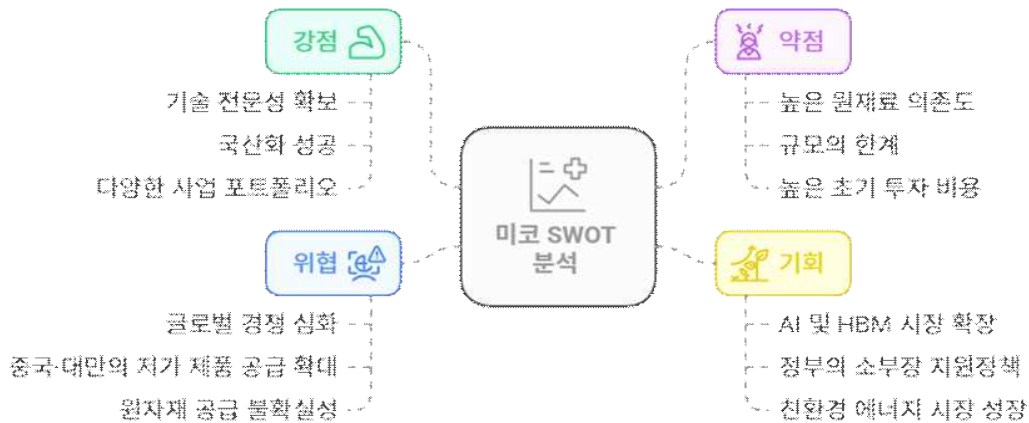
한편, 동사는 수입에 의존하고 있는 고순도 질화규소 원료 분말 국산화를 진행 중이다. 현재 Si_3N_4 원료 분말 합성 연구 성과에 대한 시제품 테스트를 진행 중에 있으며, 열전도 특성을 이용하여 발생하는 열을 외부로 방출시키는 부품으로 질화알루미늄 방열필러 소재를 개발하기 위해 질화알루미늄 과립 및 반도체 히터에서 발생하는 폐 질화알루미늄 재활용 관련 연구개발을 진행 중이다. 현재 참여 중인 국책과제는 다음의 표와 같다.

표 5. 현재 진행 중인 국책과제

사업기간	연구과제명
2022.07. ~ 2026.12.	전기차 고전력 파워모듈 방열기판(90 W/m-K 이상)용 질화규소 분말 국산화 기술개발
2024.04. ~ 2028.12.	고 열전도성 분말 세라믹 소재 개발
2024.07. ~ 2028.12.	전장용 MLCC 대응 희토류 대체 유전체 조성 및 제조 기술개발
2024.09. ~ 2028.12.	복합특성 세라믹 소재 응용 70x70mm ² 이상 대면적 급속발열 히팅모듈 제조 기술 개발
2025.04. ~ 2028.12.	태양광 패널 해외 현장 맞춤형 이동식 재활용 기술 및 글로벌 실증

출처: 동사 제공자료, NICE평가정보(주) 재가공

SWOT 분석



1. 강점 (Strengths)

- 기술 전문성 확보: 반도체 부품 세정 및 특수코팅 기술과 세라믹 부품 제조에 특화된 기술경쟁력 보유로, 국내 반도체 업계 내에서 높은 신뢰성을 확보
- 국산화 실현: 펄스 히터 국산화에 성공하여 수입 대체, 원가 절감 효과 달성, 국내 반도체 산업 발전에 기여
- 다양한 사업 포트폴리오: 반도체 세정·코팅, 세라믹 소재 및 부품 제조 외에도 고체산화물 연료전지 및 폐기물 에너지화 등 친환경 사업 영역으로 포트폴리오 다각화 및 리스크 분산

2. 약점 (Weaknesses)

- 높은 원재료 의존도: 고순도 세라믹 원료 등 핵심 소재의 상당 부분을 해외 수입에 의존
- 규모의 한계: 글로벌 세라믹, 반도체 소재 기업 대비 상대적으로 작은 기업규모
- 높은 초기 투자비용: 첨단 기술 부품의 생산시설 구축 및 유지관리에 높은 투자비용 필요

3. 기회 (Opportunities)

- AI 및 HBM 시장 확장: AI, HBM 등 고성능 반도체 시장의 확대에 따라 고기능성 세라믹 부품의 수요 증가 기대
- 정부의 소부장 지원정책: 소재·부품·장비(소부장) 국산화 및 자립화를 적극적으로 추진하는 정부 정책으로 인해 세라믹 소재 및 반도체 부품 분야의 국산 제품 활용 기회 증가
- 친환경 에너지 시장 성장: 전 세계적인 ESG 경영 강화 및 탄소 중립 목표 추진으로 고체산화물 연료전지 및 폐기물 에너지화 시장의 성장 가능성 증가

4. 위협 (Threats)

- 글로벌 경쟁 심화: 일본(Kyocera, Tokuyama), 미국(CoorsTek), 독일(CeramTec) 등 기술 선도기업과의 치열한 글로벌 경쟁 불가피
- 중국·대만의 저가 제품 공급 확대: 저가 세라믹 부품 업체들이 시장에 진입하며 가격경쟁 심화
- 원자재 공급 불확실성: 국제 공급망 불안정, 지정학적 리스크, 환경규제 강화 등으로 인해 원재료의 공급 불확실성과 원가 상승 리스크 존재

IV. 재무분석

2024년 매출 증가 및 수익성 개선

동사는 2024년 바이오 부문 지분을 매각하여 해당 사업부문의 매출이 발생하지 않았으나 국내 반도체 기업들의 가동률 회복에 따른 관련 부품의 공급 증가, 고체연료전지 관련 수주 급증으로 매출과 영업이익이 증가하고 당기순이익이 흑자 전환하였다.

■ 2024년 매출 규모 확대

동사 사업은 반도체 공정 및 디스플레이용 장비 부품을 제작하고 장비 구성 부품의 세정 및 코팅하는 반도체 사업과 고체산화물 연료전지 및 신재생에너지 제품을 제작하는 에너지·환경 사업으로 구성되어 있다. 2024년 연결 매출 기준, 반도체 사업은 전체 매출액의 97%를, 연료전지 매출은 전체의 3%를 차지하며 주요 사업 부문을 구성하고 있다. 2023년까지 바이오사업도 영위하였으나 2024년 9월 (주)미코바이오메드 지분을 매각하며 해당 사업 부문을 중단 사업으로 분류하였다.

동사는 2022년 4,148억 원의 매출을 시현한 이후 2023년 3,817억 원, 2024년에는 매출액증가율 41.6%로 5,405억 원의 매출을 기록하였다. 2023년에는 연료전지와 바이오 부문 매출이 증가하였음에도 반도체 사업의 매출액이 373억 원 감소하며 매출액이 전년 대비 331억 원 감소하였고, 2024년에는 두 사업부문의 매출이 고르게 증가하여 매출 규모가 크게 확대되었다. 2025년 2분기 동사는 현대중공업파워시스템(주)의 매출 인식과 함께 전 사업부문의 매출이 고르게 성장하며 매출이 전년 동기 대비 74.5% 증가하였다.

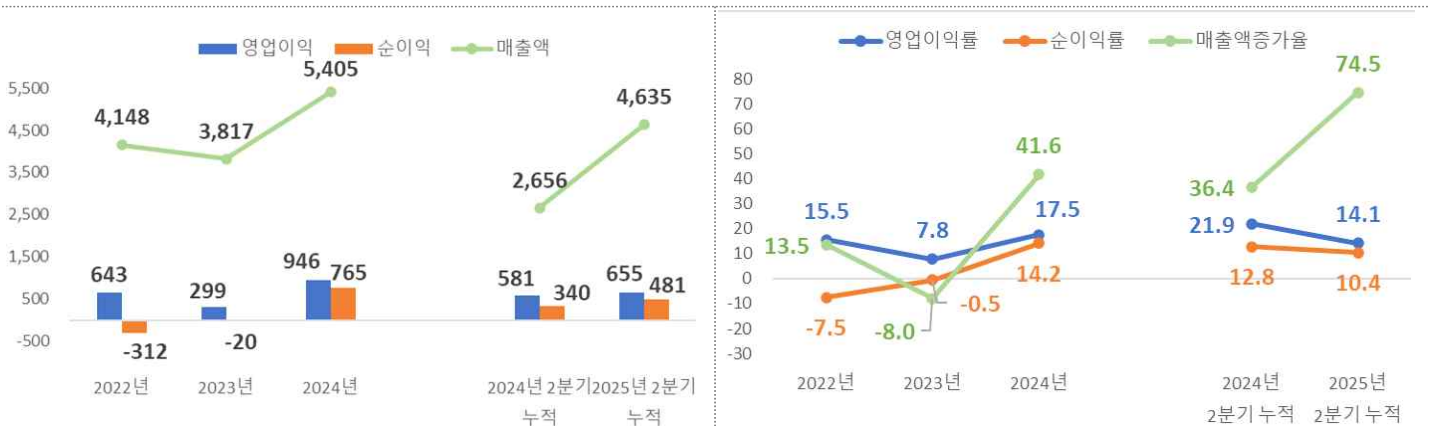
■ 2024년 영업이익 및 당기순이익 증대

2023년에는 2022년 대비 매출이 331억 원 감소함에 따라 영업이익은 2022년 대비 344억 원 축소되어 299억 원을 기록하였다. 당기순손실은 지분법이이익의 개선으로 전년 대비 292억 원 감소하여 20억 원을 나타내었다.

2024년에는 양호한 매출 신장에 힘입어 원가 및 판관비 부담 완화되며 영업이익률이 크게 상승하였다. 2023년과 비교하여 금융수지가 악화되었으나 영업이익이 전년 대비 647억 원 증가한 946억 원을 기록하였고, 기타수지 개선 등의 영향으로 당기순이익은 전년 대비 785억 원 증가하며 흑자 전환하여 765억 원을 기록하였다. 2025년 2분기에도 매출 증가와 더불어 영업이익, 당기순이익이 증가하였다.

그림 6. 동사 손익계산서 분석

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 반기보고서(2025.06.), NICE평가정보(주) 재가공

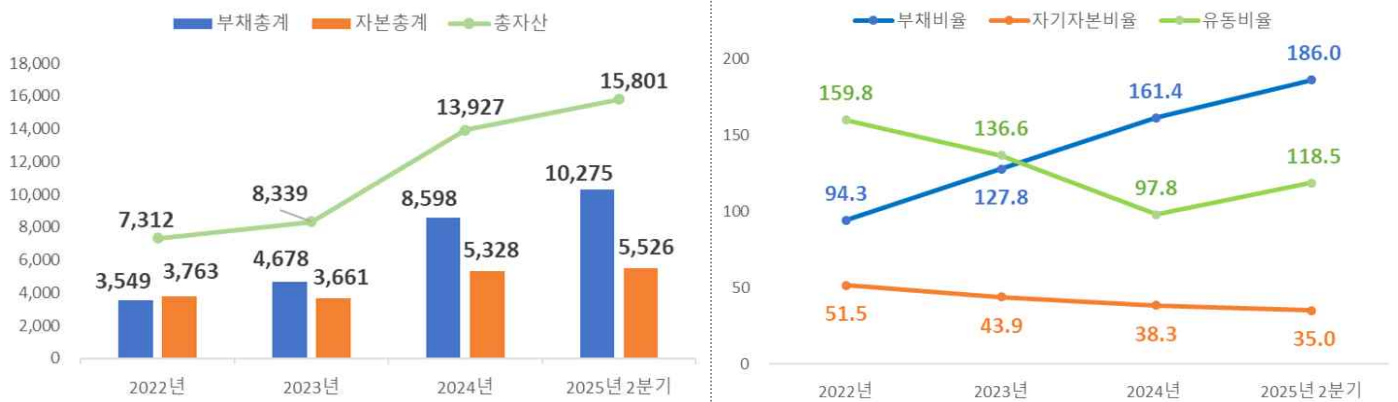
■ 자기자본비율 하락, 부채비율 상승 추세

2023년, 단기차입금, 유동성전환사채 등 유동부채 증가율이 유동자산 증가율을 상회하며 유동비율은 136.6%로 하락하였다. 지배지분이 감소하며 자본총계가 2022년 3,763억 원에서 2023년 3,661억 원으로 감소하였으나 부채총계가 증가하며 총자산이 증가, 자기자본비율이 하락하고 부채비율이 상승하여 자기자본비율 43.9%, 부채비율 127.8%를 각각 기록하였다.

2024년에도 차입금, 사채 등 유동부채가 크게 증가하며 유동비율이 97.8%로 하락하고, 비유동계약부채, 이연법인세부채 등 비유동부채도 증가하며 부채비율이 161.4%로 상승하였다. 부채총계가 증가하며 자기자본비율은 38.3%로 하락하였다. 2025년 2분기에도 부채총계와 자본총계가 증가하며 자기자본비율은 하락하고 부채비율은 상승하는 추세를 지속하였다.

그림 7. 동사 재무상태표 분석

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 반기보고서(2025.06.), NICE평가정보(주) 재가공

표 6. 동사 요약 재무제표

(단위: 억 원, K-IFRS 연결 기준)

항목	2022년	2023년	2024년	2024년 2분기 누적	2025년 2분기 누적
매출액	4,148	3,817	5,405	2,656	4,635
매출액증가율(%)	13.5	-8.0	41.6	36.4	74.5
영업이익	643	299	946	581	655
영업이익률(%)	15.5	7.8	17.5	21.9	14.1
순이익	-312	-20	765	340	481
순이익률(%)	-7.5	-0.5	14.2	12.8	10.4
부채총계	3,549	4,678	8,598	4,781	10,275
자본총계	3,763	3,661	5,328	3,990	5,526
총자산	7,312	8,339	13,927	8,771	15,801
유동비율(%)	159.8	136.6	97.8	138.4	118.5
부채비율(%)	94.3	127.8	161.4	119.8	186.0
자기자본비율(%)	51.5	43.9	38.3	45.5	35.0
영업현금흐름	804	416	1,205	617	-345
투자현금흐름	-1,291	-872	-1,613	-627	-1,184
재무현금흐름	-21	838	914	-337	1,585
기말 현금	1,320	1,705	2,249	1,383	2,255

자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 반기보고서(2025.06.), NICE평가정보(주) 재가공

■ 동사 실적 전망

글로벌 반도체 시장은 전방산업의 투자 재개와 인공지능, 전기차 등 고부가가치 응용 분야의 확대에 따라 회복세를 보일 것으로 전망되며, 이에 따라 공정 고도화와 생산 효율 향상에 기여하는 고기능성 소재 및 부품 수요도 지속적으로 증가할 것으로 보인다. 아울러 반도체 제조공정의 복잡성과 정밀성이 심화됨에 따라 정밀 세정 및 코팅 공정의 중요성이 부각되고 있으며 관련 시장의 성장 또한 가속화될 것으로 예상된다. 동시에 글로벌 탈탄소 정책과 청정에너지 전환 기조에 따라 연료전지 및 수전해 기술에 대한 수요가 증가하고 있으며 동사는 고체산화물연료전지(SOFC)를 중심으로 생산역량 확대 및 기술 내재화를 통해 관련 시장에서의 경쟁력을 강화해 나가고 있다.

2025년 2분기 동사는 에너지·환경 부문에서 909억 원, 반도체 부문에서 1,577억 원의 매출을 실현하며 매출 증가세를 이어갔다. 2025년 하반기 동사는 반도체 및 청정에너지 산업의 본격적인 성장세에 힘입어 매출이 크게 확대될 것으로 전망된다.

그림 8. 동사 사업부문별 실적 및 전망

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 분기보고서(2025.03.), 반기보고서(2025.06.), NICE평가정보(주) 재가공

표 7. 동사의 사업부문별 연간 실적 및 분기별 전망

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)

항목	2022	2023	2024	2025E	1Q2025	2Q2025	3Q2025E	4Q2025E
매출액	4,148	3,817	5,405	9,607	2,149	2,486	2,486	2,486
반도체	4,106	3,733	5,267	6,118	1,387	1,577	1,577	1,577
에너지·환경	37	84	138	3,489	762	909	909	909
바이오	6	0	0	0	0	0	0	0

* 2024년 9월 주식회사 미코바이오메드 지분 매각으로, 2023년 이후 바이오 부문 매출 미 표기

자료: 동사 사업보고서(2024.12.), 분기보고서(2025.03.), 반기보고서(2025.06.), NICE평가정보(주) 재가공

V. 주요 변동사항 및 향후 전망

상부 펄스 히터 사업 본격화와 긍정적인 연료전지 및 폐기물 에너지화 사업 환경

상부 펄스 히터 관련 해외 시장 쉐어 통과 및 초도물량 확보로 본격적인 사업화가 시작되었고, 에너지·환경 사업 부문의 긍정적인 산업 동향은 주요 종속회사의 매출 성장을 견인하여 동사 재무 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

■ 상부 펄스 히터의 해외 시장 쉐어 통과, 초도물량 확보하며 사업 본격화

동사는 그간 외산 제품에 의존해 오던 반도체 후공정 패키징 장비인 TC 본더에 탑재되어 순간적인 고온을 정밀하게 제어할 수 있는 펄스 히터의 국산화에 성공하여 해외 반도체 후공정 장비 기업(대만과 중국의 주요 반도체 패키징 업체에 TC 본더를 공급하는 장비 기업)에 메모리용 펄스 히터를 납품하며 해외 고객사 확보에 성공한 것으로 확인된다. 이는 고객사의 최종 테스트를 거쳐 실제 적용된 첫 사례로, 동사의 펄스 히터 기술이 해외 시장에서 경쟁력을 갖추었음을 입증하는 사례로 볼 수 있다. 해당 고객사는 메모리용 펄스 히터뿐만 아니라 대면적 히터 프로젝트도 동사와 함께 추진할 계획으로 장기적인 동반 관계로 이어질 수 있다.

펄스 히터는 HBM 외 고집적 반도체 패키지 공정 등 다양한 분야에 폭넓게 활용되며 고성능 반도체 패키징 기술의 필수 부품에 해당하기 때문에 국내외 시장에서 동사의 입지를 확장하는 기반 경쟁력으로 활용될 수 있다. 동사 또한 상부 펄스 히터 관련 국내 고객사 확보와 하부 히터(기존 제품) 고객사 다변화를 목표하고 있다.

■ 에너지·환경 사업 부문의 긍정적인 산업 동향

정부의 「수소경제 활성화 로드맵」과 2023년 개정된 「탄소중립기본법」 시행으로 고체산화물 연료전지 시장이 성장기에 진입하고 있으며, 국내 주요 기업의 투자가 지속 확대(출처: ‘수소 연료전지 시스템 - 중소기업 전략기술로드맵(2025~2027)’, 2025)되고 있다. 또한, ESG 경영 강화와 자원순환 촉진을 위한 환경규제 강화로 인해 폐기물 에너지화 분야의 사업 기회가 확대되고 있으며, 국내 폐기물 에너지 시설에 대한 신규 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 이러한 에너지·환경 분야의 산업 동향은 동사의 주요 종속기업인 (주)미코파워의 고체산화물 연료전지 사업과 현대중공업파워시스템(주)의 폐기물 에너지화 사업에 직접적으로 유리한 환경을 조성하고 있다. 특히 두 회사는 관련 기술과 생산능력을 갖춘 상태에서 국내 지자체 및 대기업과의 협력을 강화하며 시장 진입 및 수주 확대에 주력하고 있어 성과 확보가 기대되며, 이는 동사의 연결재무 실적 개선에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

최근 뉴스와 향후 전망

☑ 프롬프트: 동사의 최근 뉴스와 향후 전망에 대해 알려주세요.

☑ 생성형 AI 답변:

미코는 최근 자회사 미코파워를 통해 고체산화물 연료전지 시스템의 상용화를 추진하며 에너지·환경 분야 입지를 강화하고 있습니다. 탄소중립 사업채권 1호기업 선정 및 수소도시 조성 프로젝트 참여 등 ESG 신사업도 본격화하고 있습니다. 반도체 사업에서는 펄스 히터, 정전척 등 고기능성 세라믹 부품의 국산화와 탄소 복합소재 표면처리 기술 고도화를 통해 반도체 부품 시장에서의 경쟁력을 확대 중입니다.

AI·HBM 수요 확대와 정부의 탄소중립 정책 강화는 반도체·에너지 양 사업 부문 모두에 우호적인 성장 여건을 제공하고 있습니다. 특히 고체산화물 연료전지, 폐기물 에너지화 등의 친환경 에너지 솔루션은 중장

미코(059090)

기적으로 신규 매출원 역할을 수행할 것으로 예상됩니다. 이를 통해 (주)미코는 연결 기준 실적의 질적 개선과 안정적 성장 기반을 확보할 것으로 기대됩니다.

* 출처: Chat GPT

증권사 투자의견

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
-	-	-	-
최근 6개월 내 발간보고서 없음			

시장정보(주가 및 거래량)

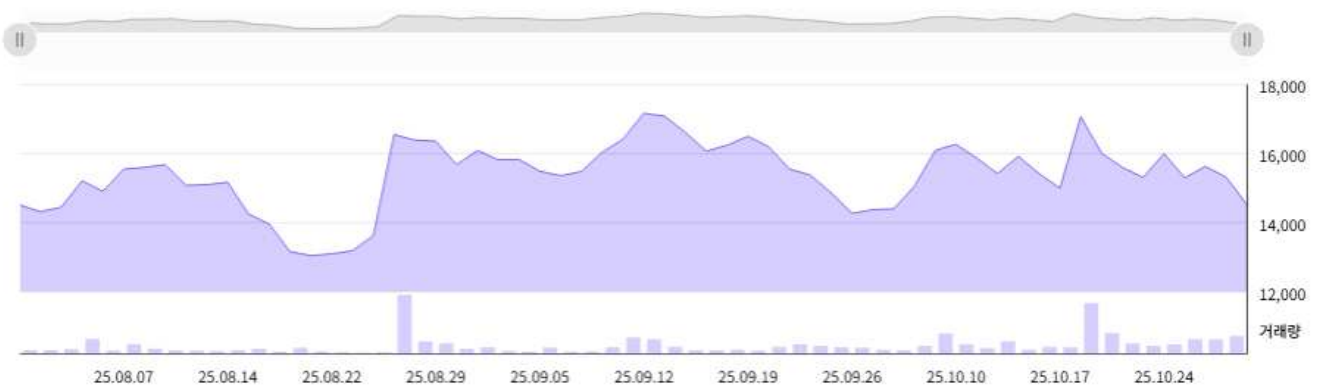
059090 코스닥

14,510 ▼800 -5.51%

기준: 2025.10.30 | 단위: 원, 주, %

전일 15,310 고가 15,350 거래량 1,145,680 주
시가 15,310 저가 14,480 거래대금 16,918 백만원

1주일 3개월 6개월 1년 3년 5년



자료: NICE BizLINE(2025.10.30)

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자 주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다.

시장경보제도는 「투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목」의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.

※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의7

기업명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
(주)미코	X	X	X